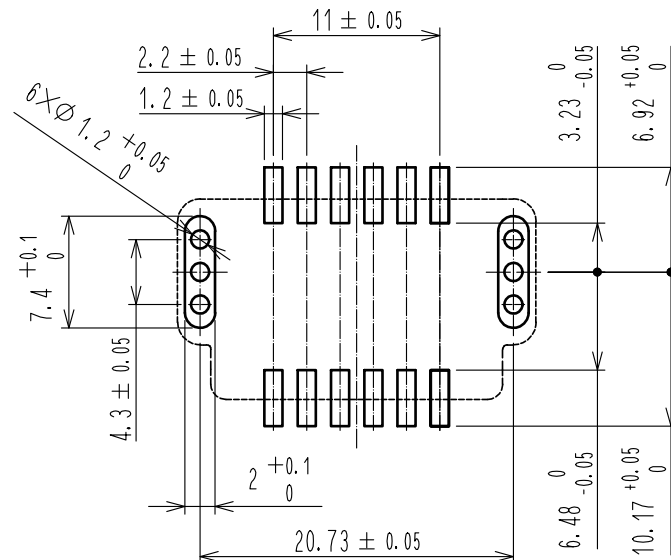
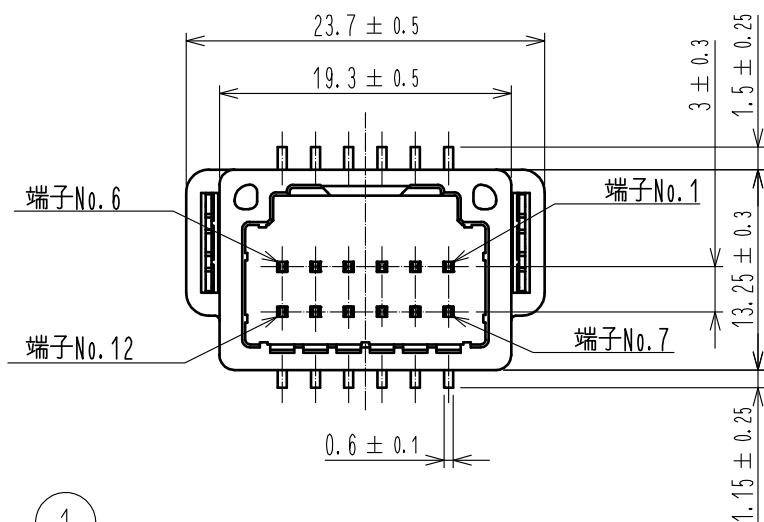
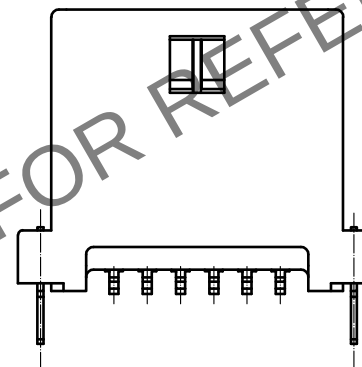
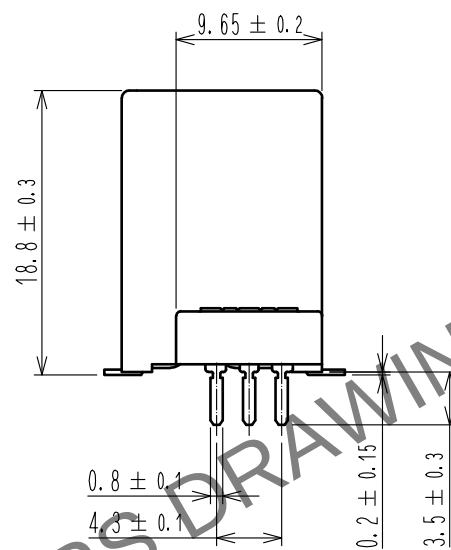
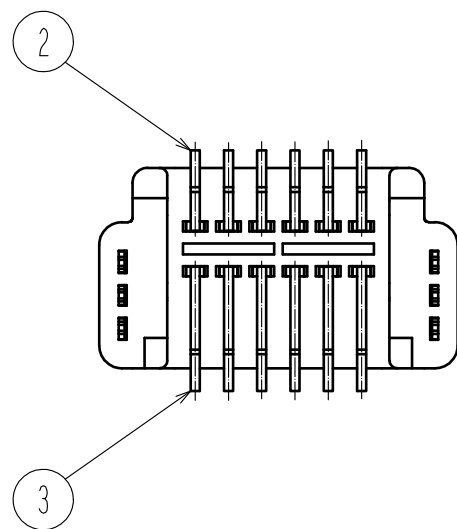
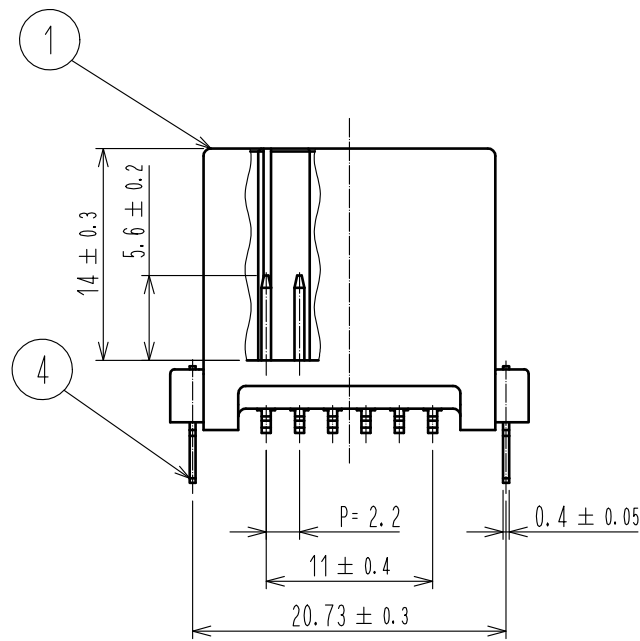


Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品

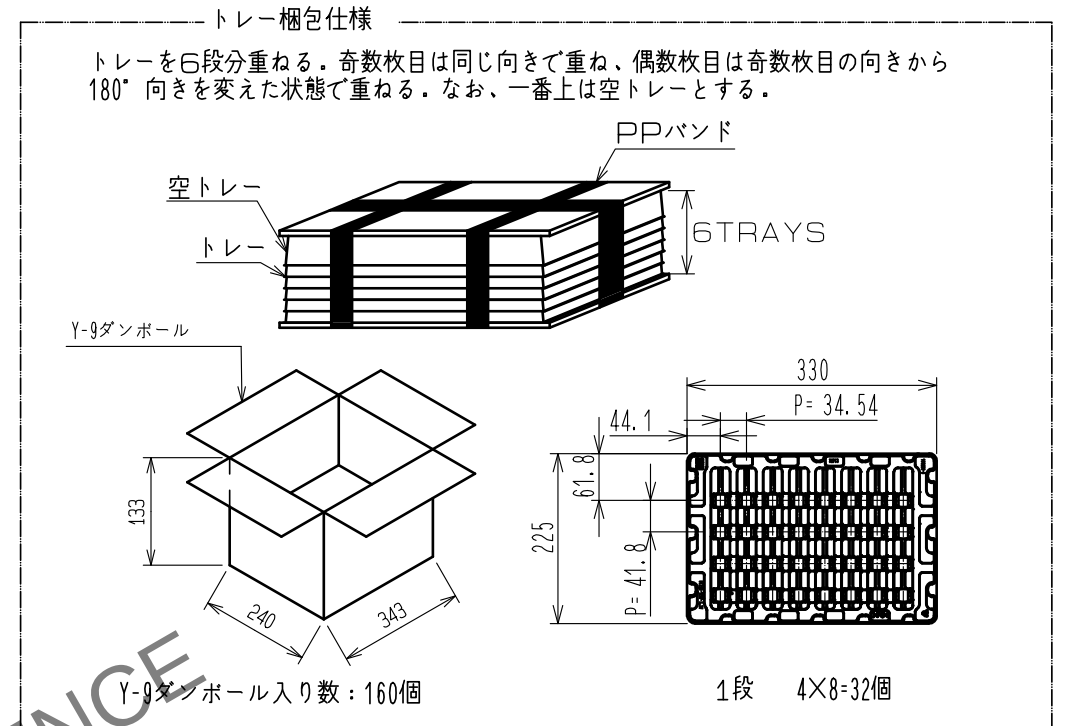
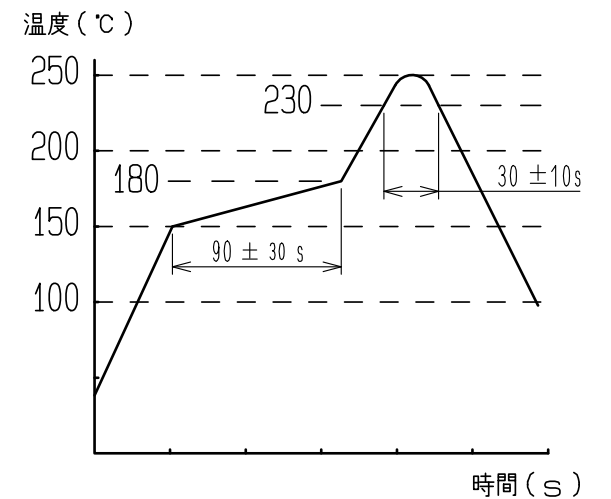


基板寸法推奨図



LOT NO.

- 注1 推奨温度プロファイル（右表参照）
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線、エアー大気中または窒素
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
60~120s
2 手ハンダ/ハンダごて温度
： 280~300℃ 2s以内
3 端子平坦度は0.1mm以下。
4 推奨基板厚は $T=1.6$ mmとする。
5 推奨はんだ厚0.15mmとする。



2	黄銅	すずめっき、T=0.64	4	黄銅	すずめっき、T=0.4
1	PPS	クロ、GF40%	3	黄銅	すずめっき、T=0.64
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED
APPROVED : HK. UMEHARA		20200928	DRAWING NO. ADC-169257-60-00		
CHECKED : HH. TSUKUMO		20200927	PART NO. GT25H-12DP-2.2V(60)		
DESIGNED : DONGCHAN KIM		20200924	CODE NO. CL775-0050-9-60		
DRAWN : AN. SAIKI		20200917	DATE		